



ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE PARED DE CONIDIAS DE TRICHODERMA SPP POR ELECTROFORESIS CAPILAR

Lilia Yunuen Salazar Alcantar¹ y Virginia Angelica Robinson Fuentes¹

¹ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. lily.sa@hotmail.com

Trichoderma spp es un hongo microscópico de amplia distribución y es muy estudiado ya que tiene una gran capacidad metabólica. Es utilizado para la producción de enzimas industriales como pigmentos y quinonas, así como para la producción de más de 100 metabolitos con actividad antibiótica; es ampliamente utilizado como control biológico. Algunas especies han resultado ser patógenos oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, provocando que estén expuestos a sufrir algún tipo de micosis. Por todo lo anterior, es necesario que la identificación de los microorganismos sea más rápida, sensible y más selectiva. En años recientes se ha propuesto a la electroforesis capilar (EC) como una técnica alternativa para este fin ya que nos permite conocer las propiedades de adherencia y repulsión que presentan las conidias a superficies y otras células. En este trabajo se utiliza la EC para estudiar algunas propiedades de superficie de conidias de *Trichoderma spp*.

Se utilizó mezcla de dos géneros fúngicos: *Agaricus bisporus* y *Trichoderma atroviride*. El BGE (buffer de corrimiento) usado fue HEPES 20mM a pH 7 y como aditivos CTAB y b-CDs. El capilar es de 100 mm d.i., T= 25°C y 17 KV, en polaridad normal. Equipo: Beckman Coulter P/ACE MDQ system.

Los electroferogramas obtenidos al usar HEPES 20mM, pH 7, mostraron múltiples señales en los corrimientos individuales de cada género fúngico. La incorporación de b-CDs, ocasionó la mejora de las señales electroforéticas de ambos géneros. Con CTAB como aditivo en el BGE, se lograron agrupar las conidias y tener señales más definidas.

El uso de aditivos en el BGE mejora las señales electroforéticas obtenidas para cada uno de los géneros fúngicos analizados lo que indica la interacción que tienen los grupos funcionales de la pared celular con los aditivos.